

2018年4月19日

各位

JX金属株式会社

圧延銅箔・高機能銅合金条および半導体用スパッタリングターゲットの生産能力の増強について
～需要拡大に対応し、それぞれ生産能力を約30%増強～

JX金属株式会社（社長：大井滋、以下「当社」）は、最先端の電子材料に必要な不可欠であるとともに当社独自の技術が活かせる圧延銅箔、高機能銅合金条および半導体用スパッタリングターゲットについて、需要の急速な伸びに対応するため、以下の通り、それぞれの製品の生産能力を約30%増強することといたしました。

なお、この設備投資は、2017-19年度の中期経営計画の基本方針の一つである「基幹事業の収益力強化」の一環であります。

1. 圧延銅箔および高機能銅合金条

当社の圧延銅箔および高機能銅合金条（コルソン合金、チタン銅）は、スマートフォンの薄型化、高機能化に伴い、急速に採用が進んでいます。更に今後は、IoT（Internet of Things、「モノのインターネット」）化やAI社会の進展に伴い、データセンターの拡大や通信機能を備えた自動車（コネクテッドカー）の開発・普及などにより、需要はますます拡大していくものと考えられます。

当社は、この需要拡大に対応するため、当該製品群の製造設備（溶解鑄造、圧延機、焼鈍炉、表面粗化処理ライン等）を増強します。今後、順次設計、建設、立上げを行い、2020年度上期にすべての設備が稼働した時点では、生産能力は2017年度比（面積ベース）で約30%増を見込んでいます。

2. 半導体用スパッタリングターゲット

当社の半導体用スパッタリングターゲットは、業界トップのシェアを有し、世界の主要半導体メーカーで採用されています。半導体デバイスは、スマートフォン、パソコン、データセンター、自動車、産業機器などのあらゆる電子機器で使われており、IoT・AI社会を迎え、需要の急速な拡大が見込まれています。また、電子機器の飛躍的な性能向上に対応し、半導体デバイスにも、更なる高集積化による高速化、高機能化、高容量化、省電力化などが要求されています。

当社は、今後の需要の拡大と、次世代半導体デバイスに求められる顧客ニーズに対応し、製品開発から量産に至るまでの安定供給体制を確立するため、半導体用スパッタリングターゲット製造設備（高純度金属精製、溶解等）を増強します。今後、段階的に設備増強を行い、2020年度の生産能力は、2017年度比で約30%増を見込んでいます。

以上